

edaForum07 – Nikolaustag in München (Teil 2)

von Cordula Hansen (ch), Peter Neumann (Ne), Ralf Popp (Pp) und Susanne Sass (Su)

Auch wenn sich das edaForum08 bereits ankündigt, möchten wir Ihnen den aus redaktionellen Gründen bisher noch nicht abgedruckten zweiten Teil des Berichts vom edaForum07 nicht vorenthalten. Im newsletter edacentrum 01 2008 wurde bereits über die Keynote von Prof. Dr. Hermann Eul von Infineon, die ‚Company Presentations‘ und die beiden auf ökonomische Themen ausgerichteten Sessions „Nutzen der Mikroelektronik für die Medizin“ und „Konsolidierung der Halbleiterindustrie“ berichtet. In dieser Fortsetzung des edaForum-Berichts werden die technischen Sessions mit den Themenbereichen „Beherrschung der Mixed-Signal-Integration“ und „Zusammenarbeit von Hard- und Softwareentwicklung“ behandelt. Doch zunächst möchten wir etwas richtig stellen:

Richtigstellung zur Berichterstattung edaForum07 im newsletter edacentrum 01 2008:

In der Berichterstattung der Business Session II „Semiconductor Industry Consolidation: How Many Will Survive“ zum Vortrag von Thomas Hötzel mit dem Titel „Transformation of an East German Technology Portfolio into a Medium-Sized Global ‚Fabless Company‘ in the Analog Mixed Signal Segment“ ist uns bzgl. Ertrag und Umsatz der Firma ZMD ein Fehler unterlaufen, den wir hier berichtigen möchten. Richtig muss es heißen:

ZMD gehört seit 2007 zu den „fabless SMEs“ und hat in 2007 mit dem sich gut entwickelnden Produktgeschäft einen Umsatz von \$ 70 Mio erzielt, was gegenüber 2006 einem Wachstum von über 20% entspricht.

Wir bedauern, dass uns dieser Fehler in der Berichterstattung unterlaufen ist. (ch)

Lesen Sie auf den folgenden Seiten den zweiten Teil der Zusammenfassungen der wichtigsten Statements der Vortragenden der technischen Sessions auf dem edaForum07. (Pp)

Technical Session 1:

“STILL HAVEN’T FOUND, WHAT I’M LOOKING FOR – Mixed Signal Integration – All done?”

Prof. Dr. Georges Gielen, KU Leuven

Georges Gielen, Professor an der Universität Leuven, ging in seinem Vortrag „Analog Design Automation – Dream or Reality?“ auf aktuelle Simulations- und Modellierungstechniken für Entwurf und Verifikation, auf neueste Aspekte für Schaltungs- und Layoutsynthese, sowie auf die Signalintegritäts- und Verlässlichkeitsanalyse ein. Da inzwischen 70–80% der Chips Analog-/Mixed-Signal- (A/MS-) Designs sind (Tendenz

steigend), liegen die Gründe für Re-Spins immer häufiger im Analogdesign. Aufgrund von steigender Verlustleistung und sinkender Versorgungsspannung verbunden mit wachsender Variabilität und zunehmendem Bedarf an Signalintegrität gelte es, in der „Nano-CMOS-Ära“ Wege mit neuen Materialien und Bauteilen zu beschreiten, um Herausforderungen wie den „leakage canyon“, das „variability valley“ und den „supply drop-off point“ zu meistern. Am Beispiel der drahtlosen Ultra-Low-Power-Sensor-Netzwerke veranschaulichte Gielen die Komplexität der Zukunft des A/MS-Entwurfs.



Abbildung 3.05: Prof. Dr. Georges Gielen, KU Leuven

Newsletter edacentrum Probeauszug
Bestellen Sie sich den kompletten Artikel
über newsletter@edacentrum.de

edacentrum, Hannover, Oktober 2008